

WebDB Forum 2018 ご協賛プランと特典一覧（一般向け）

	ご協賛特典	プラチナ プラン	ゴールド プラン	シルバー プラン	ブロンズ プラン
	ご協賛金	30 万円	20 万円	10 万円	5 万円
1	ポスターレセプション（懇親会）での出展	○ (ブース大)	○	○	○
2	Web サイト、プログラムへの社名、ロゴの掲載	特大	大	中	小
3	WebDB Forum 2018 への無料参加枠	4 名	3 名	2 名	1 名
4	ご協賛企業の社員様の参加費割引 (お一人あたり 4,000 円で参加可能)	○	○	○	○
5	冠スポンサー茶菓提供権（先着 5 社） ※別途、3 万円のご負担が必要です	○	○	○	○
6	テクノロジーショーケースへの登壇 ※枠数超過の場合は上位プラン・先着優先	○ (約 30 分・2 枠)	○ (約 30 分)	○ (約 15 分)	—
7	参加者配布資料へのアイテムの封入・同梱 (A4 サイズのフライヤー 1 枚、小冊子、小さな グッズのいずれかのアイテムを選択可能)	3 個まで	2 個まで	1 個まで	—
8	参加者配布バッグへのロゴ掲載 【ロゴ入稿期限： 8 月 3 日（金）】	大	中	小	—
9	常設ブースの設置 ※枠数超過の場合は上位プラン・先着優先	○ (ブース大)	○	○	—
10	学生発表に対する企業賞授与	○	○	—	—
11	冠スポンサー昼食会開催権（先着 3 社） ※別途、昼食のご手配が必要です 【申込期限： 7 月 20 日（金）】	○	—	—	—
12	冠スポンサーポスターレセプション（懇親会） 開催権（先着 1 社） ※別途、50 万円のご負担が必要です 【申込期限： 7 月 20 日（金）】	○	—	—	—
13	カンファレンスバッグのご提供（先着 1 社） 【申込期限： 7 月 20 日（金）】	○	—	—	—
14	冠スポンサー託児サポート ※プラン策定中、別途費用ご負担が必要です	○	○	○	○

【スケジュール】

2018 年 7 月 20 日（金） プラチナスポンサー特典（冠スポンサー昼食会、冠スポンサーポスターレセプション、カンファレンスバッグのご提供） 申込期限

2018 年 8 月 3 日（金） 上記以外の全特典 申込期限、ロゴ入稿期限

【ご協賛の申込方法】

以下のご協賛申込フォームよりお申し込みください。

<http://bit.ly/webdbf2018-sponsorship> (締切 2018 年 8 月 3 日 (金))

※申込フォームは 6 月 15 日 (金) 12:00 にオープンいたします

不明な点などございましたら、産学連携担当<webdb2018-sangaku@lsc.c.titech.ac.jp>までご質問ください。

【ご協賛金のお支払いについて】

ご協賛金につきましては、旅行代理店の京王観光株式会社よりご請求させていただきます。

後日、申込フォーム記載の担当者様にご連絡差し上げます。

【ご協賛特典のご案内】

1. ポスターレセプションでの出展 (希望社のみ)

- 9 月 12 日 (水) の夕刻に開催予定のポスターレセプション (懇親会) にご出展いただけます。
例年と異なり、1 日目の開催となる点にご留意ください。
- ポスターレセプションの開催場所は、東京工業大学大岡山キャンパスに隣接する「東工大蔵前会館」内の 1 階「くらまえホール」「ロイヤルブルーホール」となります。施設概要については以下のページをご参照ください。
<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/floor/>
- 展示ブースでは、技術的な内容に加えて、製品やサービスの紹介、採用関係の説明等を行っていただくことも可能です。
- ポスターレセプション時には、WebDB Forum 2018 の無料参加枠とは別に、3 名の社員様にご参加いただくことができます。
- プラチナプランの協賛企業様は、ご要望により大きめのサイズのブースの出展が可能です。
- 申込フォーム記載の内容 (出展あり、なし) に変更がある場合は **8 月 3 日 (金)** までに、ご協賛申込フォームでの修正をお願いいたします。



(ご参考) WebDB Forum 2017 のポスターレセプション

2. Web サイト、プログラム等への社名、ロゴの掲載

- WebDB Forum 2018 の公式 Web サイト・参加者配布資料に、協賛企業様の社名・ロゴの掲載をいたします。掲載させていただくロゴの大きさは、ご協賛プランにより変わります。
- ロゴには、協賛企業様ご指定のウェブページへのハイパーリンクを付与させていただきます。
- 協賛申込フォームに下記の情報をご指定ください。
 1. リンク先 URL
 2. リンク文字列（≒ALT 属性）

申込フォーム送信後、産学連携担当<webdb2018-sangaku@lsc.c.titech.ac.jp>までロゴデータを添付ファイルでお送りください。ファイル形式は、Illustrator 形式（AI ファイル、デザイン規定上の指示があればそれも含む）もしくは SVG 形式を推奨とし、十分な解像度の PNG 形式または GIF 形式も可とします。

3. WebDB Forum 2018 への無料参加枠

- WebDB Forum 2018 への無料参加枠を、プランに応じて提供させていただきます（プラチナ：4 名，ゴールド：3 名，シルバー：2 名，ブロンズ：1 名）。無料参加枠で参加される場合は、別途郵送の無料参加券を当日受付にご提示ください。

4. ご協賛企業の社員様の参加費割引

- 特典 3 の無料参加枠を超える場合でも、協賛企業の社員様は、割引価格（4,000 円）にてご参加いただけます。
- 当日、社員証等、協賛企業の社員様と証明できるものをご持参いただき、受付にご提示ください。

5. 冠スポンサー茶菓提供権（先着 5 社）

- 会議期間中、参加者に茶菓を提供するスペースに協賛企業様のロゴを掲出できる特典です。
- ご協賛金とは別に、茶菓代として 3 万円をご負担いただきます。

6. テクノロジーショーケースへの登壇（シルバープラン以上の希望社のみ）

- WebDB Forum の目玉企画として認知されており，例年大変好評をいただいている「テクノロジーショーケース」（旧名称「技術報告セッション」）を，引き続き開催いたします．
- 9 月 12 日（水），13 日（木），14 日（金）に開催予定のテクノロジーショーケースにてご発表いただけます．
- ご発表の内容は技術的な内容に限らせていただきます．
- 発表時間（質疑応答込み）は，プラチナ・ゴールドプランは 1 枠約 30 分，シルバープランは 1 枠約 15 分を予定しています．プラチナプランでは 2 枠までのご発表の希望を承ります（多数の発表申し込みがあった場合はご希望に添えない場合がございますのでご承知おきください）．
- **申込み締切は 8 月 3 日（金）**とさせていただきます．
- 協賛申込フォームにて以下の項目をご入力ください．
 1. 発表タイトル
 2. 発表者名
 3. 発表者所属
 4. 発表者メールアドレス
 5. 発表概要
 6. 技術分野（3 つまで選択）
 - ① データベース基盤技術
 - ② ビッグデータ解析・高速データ処理技術
 - ③ メディア処理技術（自然言語処理，画像処理，音声処理など）
 - ④ 情報検索・推薦・広告サービス
 - ⑤ Web・ソーシャルメディア
 - ⑥ エンターテインメント
 - ⑦ その他
- 申込み企業様多数の場合には，上位プラン優先・プラン内先着順にてご登壇希望を承ります．
- 他社と発表テーマが著しく類似する場合には，発表テーマの調整について産学連携担当からご相談させていただく場合がございます．
- セッションの詳細なタイムテーブルは 8 月 24 日（金）頃，ご連絡させていただきます．ご発表日時については基本的に産学連携担当にご一任いただきますが，どうしてもご都合がつかない日時がございましたら，お申し込み時にフォームにてお知らせください．可能な範囲で調整させていただきます．
- テクノロジーショーケースの発表資料などを Web で公開された場合，WebDB Forum 2018 の Web サイト掲載のプログラムからのリンクを貼るとともに，Facebook, Twitter などの SNS でも紹介させていただきます．リンクの設定を希望される場合は，9 月 18 日（火）までに産学連携担当 <webdb2018-sangaku@lsc.c.titech.ac.jp>に URL をお知らせください．

7. 参加者配布資料へのアイテムの封入・同梱（シルバープラン以上の希望社のみ）

- 参加者の配布資料の中に、協賛企業様のフライヤー・グッズ等のアイテムの封入・同梱をさせていただきます。
- 封入できるアイテムは、「A4 サイズのフライヤー1 枚」「小冊子」「小さなグッズ」のいずれかを選択できます。ゴールドプラン以上の場合は、複数の種類のアイテムの組み合わせが可能です。
【プラチナプラン】アイテム 3 個まで
【ゴールドプラン】アイテム 2 個まで
【シルバープラン】アイテム 1 個まで
- 同じ種類のアイテムを 2 個以上封入される場合（例えばフライヤー2 枚、小冊子 2 冊など）は、他社のアイテムとの混同を避けるため、事前に封筒やクリアファイルなどで一つにまとめた上でご送付いただくようお願いいたします。また、他の種類との組み合わせになる場合も、事前にまとめていただくことが望ましいです。
- 各アイテムは 450 個(枚)を目安にご準備ください。
（450 個あることが望ましいですが、450 個以下の場合は、先着順にて参加者に配布いたします）
（ご参考）WebDB Forum 2017 参加者数：345 名
- アイテム一式は、9 月 5 日（水）午前中、もしくは 9 月 6 日（木） 午前中の日時指定にて以下の宛先に到着するように、ご送付いただきますようお願いいたします。
〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1 W8-63 西 8 号館 E 棟 701 号室
東京工業大学 情報工学系 宮崎研究室 宛
Tel. 03-5734-2687
ご送付の際は、外箱の目立つ箇所に以下の文字を大きく明記してください。
WebDB Forum 2018 / [御社名] / [梱包物名]

8. 参加者配布バッグへのロゴ掲載（シルバープラン以上の希望社のみ）

- 参加者に配布する資料、グッズなどを封入する紙バッグに、協賛企業様ご提供のロゴを掲載させていただきます。
- ロゴファイルのご送付については特典 2 と同様ですが、ファイル形式は Illustrator 形式（AI ファイル）を強く推奨いたします。
- 特典 13「カンファレンスバッグのご提供」にお申し込みの企業様がいらっしゃらない場合、本特典は提供いたしませんので、ご了承ください。
- 本特典をお申し込みの場合は **8 月 3 日（金）** までに、ご協賛申込フォームへのご入力およびロゴファイルのご入稿を完了くださるようお願い申し上げます。

9. 常設ブースの設置（シルバープラン以上の希望社のみ）

- 会議期間中、ご利用いただけるブースを設置させていただきます。
- 常設ブースには、A0 サイズのポスターを掲示できるスペース、および机・椅子をご用意させていただきます。
- 出展スペースには限りがございます。申込み企業様多数の場合には、上位プラン優先・プラン内先

着順にて承ります。

- プラチナプランの企業様には、大きめのサイズのブースを用意させていただきます。また、ブースの設置場所は、協賛プランの別を考慮いたします。
- 常設ブースでは、技術的な内容に加えて、製品やサービスの紹介、採用関係の説明等を行っていただくことも可能です。

10. 学生発表に対する企業賞授与（ゴールドプラン以上の希望社のみ）

- 優秀な研究発表を行った学生に対し、協賛企業様より企業賞を授与していただきます。
- 受賞者は、協賛企業様それぞれで決定していただきます。
- 企業賞授与の際には、協賛企業様のオリジナリティあふれる副賞をご用意ください。ご参考までに、過去に受賞した学生から喜ばれた副賞の事例を以下に示します。

【今後の研究に活用できるもの】

ディープラーニングの研究をしている学生などを念頭に、GPGPU カードなどを贈呈

【研究室の全員で楽しんでいただけるデバイス】

研究室の飲み会や旅行などで活用していただけるデバイス（360° カメラなど）を贈呈

【強いメッセージ性のある副賞】

「研究を頑張ってほしい」という意味を込めて、「エナジードリンク 1 年分」などの賞品を贈呈

【入手の心理的ハードルが高いデバイス】

Kickstarter でしか買えない VR 系デバイスやドローンなどを贈呈

【特別な機会の提供】

賞品ではなく、オフィス見学へのご招待やキーパーソンの方とお食事など、学生がふだんなかなか得られない機会を副賞として提供

- 受賞者間の公平性という観点から、市価 10 万円を超えるような高価な副賞はご遠慮いただくようお願いいたします。
- 企業賞授賞式は、9 月 14 日（金）夕刻を予定しております。
- 企業賞授賞式の直前に、企業賞選考委員会を開催いたします。企業賞を授与される企業様は必ずご出席くださるようお願い申し上げます。



（ご参考）WebDB Forum 2017 の企業賞授与式の様子

11. 冠スポンサー昼食会開催権（先着 3 社）（プラチナプランの希望社のみ）

- WebDB Forum 2018 開催期間中の 9 月 12 日（水）、13 日（木）、14 日（金）いずれかの昼食時間帯に、お申込み企業様主催の昼食会（約 60 分）を開催することができます。
- 昼食会の開催場所は、東京工業大学大岡山キャンパス内の百年記念館（博物館）4 階「ミーティングスペース」です。プレゼンテーション用のスクリーン、プロジェクタおよびマイク設備が利用可能です。座席・机を追加搬入し、60 席以上を確保いたします。昼食会への参加募集の際は、会場スペースの面積、参加者に應對される社員様の数などを考慮して最大募集人数を決定してください（最大 50 名ほどの募集がなされているのが通例です）。
会場情報: <http://www.cent.titech.ac.jp/Information/Meetingroom.html>
- 昼食会への参加募集および参加申込受付は、お申し込み企業様に行っていただきます。なお、前述の「参加者配布資料へのアイテムの封入・同梱」特典を利用して告知リーフレットを配布していただくことも可能です。また、Twitter や Facebook などのソーシャルメディアで告知を行われる場合は、大会アカウントなどで適宜拡散いたします。
- プラチナプランのご協賛金とは別に、昼食のご手配をお申し込み企業様に行っていただきます。
- 本特典をお申し込みの場合は **7 月 20 日（金）** までに、ご協賛申込フォームにご入力くださるようお願い申し上げます。
- 申込み企業様が複数の場合には、先着順にて希望を承ります。また、開催日の希望が重複した場合には、先にお申し込みいただいた企業様の希望を優先いたします。

12. 冠スポンサーポスターレセプション開催権（先着 1 社）（プラチナプランの希望社のみ）

- 9 月 12 日（水）の夜の時間帯に開催予定のポスターレセプション（懇親会、約 2 時間）を、協賛企業主催のポスターレセプションにすることができる特典です。
- お申込みいただきました企業様には、下記のような内容を想定しておりますが、具体的な内容は応談可です。（学会のイベントとなりますので、ご希望に沿えないこともございます。あらかじめご了承ください）
 1. ポスターレセプションにて、企業様からお話しいただく時間を確保させていただく
 2. 飲食用テーブルに企業様のグッズを設置させていただく
- プラチナプランのご協賛金とは別に、50 万円の追加夕食代をご負担いただきます。
- 本特典をお申し込みの場合は **7 月 20 日（金）** までに、ご協賛申込フォームにご入力くださるようお願い申し上げます。
- 申込み企業様が複数の場合には、先着順にて希望を承ります。

13. カンファレンスバッグのご提供（先着 1 社）（プラチナプランの希望社のみ）

- 参加者配布資料・グッズを配る際の封筒を、協賛企業様ご提供のカンファレンスバッグに差し替えさせていただきます。
- カンファレンスバッグの全体のデザインは協賛企業様にお任せいたしますが、特典 8「参加者配布バッグへのロゴ掲載」にて各社様から提供されたロゴの掲載について、産学連携担当との協議に応じていただくこととなりますので、ご理解の上お申し込みください。
- 本特典をお申し込みの場合は **7 月 20 日（金）** までに、ご協賛申込フォームにご入力くださるよう

お願い申し上げます。

- 申込み企業様が複数の場合には、先着順にて希望を承ります。

14. 冠スポンサー託児サポート（プラン策定中）

- 昨年に引き続き、参加者への託児サポートの提供を予定しております。今回、利用者の託児料の自己負担を軽減あるいは無料化し、ダイバーシティ推進に資することを目的に、冠スポンサーの募集を計画しております。
- 利用者からのニーズを踏まえつつ、冠スポンサーのプランを策定いたします。ご関心をお持ちの企業様は、ご協賛申し込みフォームにてご希望をお知らせください。後日、冠スポンサープランのご案内を差し上げます（なお、プランの設定を見送る可能性もございます）。

【会場におけるインターネット利用環境について】

東京工業大学大岡山キャンパス内では、ポスターレセプション、テクノロジーショーケース、常設ブースのいずれの会場においても、有線 LAN によるインターネット接続サービスはご提供できません。共用の無線 LAN 接続サービスはご提供予定ですが、多数の利用が集中すると予想されることから、接続の安定性は保証できません。恐れ入りますが、安定したインターネット利用環境を必要とされる場合は、貴社においてモバイル接続環境などの確保をお願いいたします。

【アンチハラスメントポリシーについて】

WebDB Forum 2018 では、すべての講演者及び参加者が自由に議論できる環境とするため、下記のアンチハラスメントポリシーを策定しております。

テクノロジーショーケースでのご発表、常設ブースおよびポスターレセプションでのご出展、学生を含む参加者とのコンタクトなどにおいて、下記のアンチハラスメントポリシーを遵守いただくことにご同意いただいた上で、協賛をお申し込みください。

WebDB Forum 2018 は、すべての講演者及び参加者が自由に議論ができることに尽力します。私たちはどのような形態であれ参加者へのハラスメント行為を容認しません。

ハラスメントとは、性差、性同一性と表現、性的指向、障害、外見や身体的特徴、人種、宗教、公共的な場での性的な画像や類する表現、脅迫、ストーカ、望まない写真撮影や録音・録画、不適切な接触、およびそれらに関連した不快な言動、企業の立場を利用した学生へのパワハラも含まれます。すべての参加者が安心してイベントに集中できるよう、これらのハラスメント行為が行われないようにしてください。

これらのハラスメント行為を目撃したり耳にした場合は主催者までご連絡ください。皆様のご協力をお願いします。

【参考：WebDB Forum 2018 開催概要】

名称：第 11 回 Web とデータベースに関するフォーラム（WebDB Forum 2018）

会場：東京工業大学 大岡山キャンパス（東京都目黒区大岡山 2-12-1）

日程：2018 年 9 月 12 日（水）～14 日（金）

主催：情報処理学会データベースシステム研究会

日本データベース学会

電子情報通信学会 データ工学研究専門委員会

昨年協賛企業：

Yahoo! JAPAN（ヤフー株式会社）、株式会社 Cygames、チームラボ株式会社、株式会社リクルートテクノロジーズ、株式会社 LIFULL、株式会社 FRONTEO、楽天株式会社 楽天技術研究所、Sansan 株式会社、株式会社日立製作所、株式会社東芝、富士通株式会社、株式会社博報堂、Google、株式会社サイバーエージェント、日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所、株式会社ホットリンク、株式会社 Gunosy, SRA OSS, Inc. 日本支社、富士ゼロックス株式会社、株式会社ビルディット

来場見込：350 名（※ご参考: WebDB Forum 2017 参加者数 345 名）

URL：<http://db-event.jpn.org/webdbf2018/>

以上